

# Chemicals contained in products

## Package-type

Epson Package name; **SOP3C-8PIN**

JEITA Package name; **(P-LSOP08-04.40x05.00-1.27)**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.152 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content *Note2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	7.9	シリコン	7440-21-3	7.9	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00002	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00004	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0002	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00004	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00002	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0002	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0002	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0002	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00002	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.16	ポリイミド	-	0.16	100000	保護膜 ※4
			ダイアタッチ材	0.13	銀	7440-22-4	0.11
	エポキシ樹脂	-	0.019		144444	接着剤	
	フェノール樹脂	-	0.004		33333	接着剤	
	端子メッキ	1.40	錫	7440-31-5	1.4	975000	鉛フリーはんだ
			銀	7440-22-4	0.035	25000	鉛フリーはんだ
	リードフレーム	36	ニッケル	7440-02-0	15.1	415000	導体材
			鉄	1309-37-1	20.7	570000	導体材
			銀	7440-22-4	0.18	5000	インナーリードメッキ
			その他 ※5	-	0.36	10000	添加剤
			ボンディングワイヤー	0.33	金	7440-57-5	0.33
	モールド樹脂	106	エポキシ樹脂	-	21.1	200000	主成分
			三酸化アンチモン	1309-64-4	3.2	30000	樹脂難燃剤
			ブロム化エポキシ樹脂	-	3.2	30000	樹脂難燃剤
			シリカ	60676-86-0/-	72.1	682000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.32	3000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	5.3	50000	硬化剤
			有機リン化合物	-	0.53	5000	硬化促進剤

### 化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。
- ※5 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。